(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-91991

⑤Int. Cl.³
B 23 K 20/06

識別記号

庁内整理番号 7516-4E 係公開・昭和56年(1981)7月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈アルミニウム管棒と異種金属管棒の接合方法

顋 昭54-169908

②出 願 昭54(1979)12月26日

⑫発 明 者 秋月東士郎

横浜市戸塚区矢部町756

⑪出 願 人 秋月東士郎

横浜市戸塚区矢部町756

個代 理 人 弁理士 小野寺悌二

明 細 彎

1.発明の名称

@特

アルミニウム管産と異種金属管権の接合方法 2. 特許讃求の範囲

アルミニウム管標と異種金属管標の各端で、アルミニウム管標と異種金属管標合面とし、アルミニウム管機は性質のには性が、ニッケル、鍋の単独或は理解を形成はニッケル、鍋の食物を形成はニッケル、鍋の食物を形成はニッケルを発展をでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーので

8. 発明の詳細な説明

本発明はアルミニウム質構取はアルミニウム合金質様(以下アルミニウム質と云う)と飼。

鋼、黄銅などの共種金属管機の重ね継ぎ(突き合せも含む)による接合方法に関するものである。尚「管機」とは管或は爆の意味である。

薄肉のアルミニウム管権と異種金属管器との接合に際し、溶解融溶接やその他の溶接では接合部の接合境界面に傾くて脆い厚い金属間化合物が生成されて機械的弱点があり実施し難い。

然しながらこの方法によるときはニッケル合金の尺機層を介在させない場合の接合よりも遙

かに良い結果が得られるが、尚使用目的に応じた所要強度が得られない遅れがあるばかりかれない遅れがあるはかか有しないなる。このことはアルミニウム設面をモックル投資を全性関係がよった、その他アルミニウム酸化物を介しての接合反応となりアルミニウム解化物の選元が完全に行なわれないことに基因する。

本発明は削水の電磁圧接装置による汎用接合法を改良したもので、更に接合強度を高めると共に接合条件を安定させて歩留りを良くしようとするものである。

本発明者は様々研究を首ねた結果アルミュウム管理部の接合面に出鉛、ニッケル、鯯、黄銅の単独取は型鉛とニッケル、鯯と亜鉛合金により金属度といった。と共に異独金属管理側の接合面にニッケル電気メッキ皮膜を施して互いの移合面を突き合せ取は嵌合し、この接合部にも低圧接装置により誘導加熱、電磁的加圧力を

皮である。

### 実施例 2

嵌合接台面 1 a に 亜鉛とニッケルの 合金以膜例

官化何約10%、肖化ニッケル10%、 ロッシェル約1%、 前性ソータ50% 溶液 に約40℃ 撹拌下で約90 秒処理し沈滑さ せた後水洗乾燥。

### 奖施例 8.

嵌合接合面 1a にニッケル皮膜例

## 実施例 4.

嵌合接合面 1 = に知皮膜例

城的> 150g/l 岩形にアンモニア水を機 監色を呈する迄加え、更に實験加里解液を 無色を呈する迄加えた熱器液に30~60秒 施すことにより、より強制な接合強度を得ると 共に接合条件も安定し不良品の発生が始んどな くすることに成功した。

本語明を更に詳記に説明するとアルミニウム 管1と、鯯、鯯、黄鯯などの共殖金属的2との 各端部を雌雄の嵌合接合面1s、2sとし、アルミニウム質1の嵌合接合面1sには中씱、ニッケル、鯯、貴鍋の単独 は亜鉛とニッケル、鯯と亜鉛の合金による金属及膜3を形成せしめるのであるが、先ずアルミニウム質1の嵌合を合面1sを苛性ソーダ溶液(45g/l)で30~ 60秒常温処理した後水洗して前処理を施こし、これに以下の実施例の如く金属皮膜3を形成する 実施例1.

## 嵌合接合面 1 \* に亜鉛皮膜例

酸化蚯鉛 100 g/ℓ、塩化アルミ 50 g/ℓ 苛性ソーダ 5 2 5 g/ℓの常温溶液に 30~60 砂浸漬し沈着させた後、水洗、乾燥させる。 亜鉛皮膜の厚さは 0.016 ~ 0.048 mg/cfi 福

授責し沈治させた後、水洗後防爆。 実施例 5.

# . 嵌合接合面 1 a に 世 飼 皮 膜 例

青化第一銅 11g、 育化亜約 7g、 1a 化カリ 13g、 硫酸ソーダ 25g、 亜硫酸ソーダ 8.5g、 を水 1 ℓ に溶解させた熱溶液に 30~60 秒受債し沈着させた後、水洗砂燥。

他方銅、黄蚓、銅等の異種金属管 2 の嵌合接合面2mにはニッケルを電気メッキにより皮膜してニッケル電気メッキ皮膜 4 を形成する。このニッケル電気メッキ皮膜 4 の厚さは 5 ~ 7 *4* 程度である。

かようにして金属皮膜3或はニッケル電気メッキ皮膜4を形成した互いの嵌合接合面1。、2。を篏合して接合部5となし、この接合部5を別途電磁圧接接置6の加工コイル7内に挿入配置し、この加工コイル7内において高周波電流(例えば8.1KH2)によって上配嵌合接合面1。、2。を啓顧点以下に誘導加熱した後イグナイトロン8を動作させ直流電源9よりコンデンサー10に

特開昭56- 91991(3)

充電されたエネルギーを数加工コイル 7 に瞬時に送ることにより加工コイル 7 に衝線大電流を発生させ、この電流により発生する破界により加工コイル 7 内に挿入された形合部 5 は単磁的加圧力を供て接合される。

この本発明法の接合によって得た接合境界面の台金属(金属間化合物 )は、アルミニウム質と共復金属質の直接接合の場合と比較し極めて減くて強固であり接合強度も強固で接合条件も安定している。

又共権金属管にニッケルメッキ皮膜を形成させない場合にアルミニウム管側に本発明と同様の金属皮膜3を形成して電磁圧接装置6により接合しても本発明による接合と比較して良好なる接合は得られない。このことは高周波加熱中の飼管又は黄銅管(共2を気管)側の嵌合接合面の酸化に基固する接合不完全によるものである。

又糾曹、黄州曹等の共福安國寳の嵌合接合面 にニッケル電気メッキ皮膜を配し、アルミニウ

部を電磁圧接接置の加工コイル内に配置して誘 導加熱した後接合船に大電流のパルスを与えて 軍磁的加圧力により接合するもので、その結果 アルミニウム管経と異植金属質器の直接接台、 或はアルミニウム智様と異様金属管棒の何れか 一方にのみ削者には金属皮膜処理を、後者には ニッケル解気メッキ以腹処理を施した接合と比 収して極めて接合強度が強く、而も安定した接 合が得られた。このことは本発明法の場合アル ミニウム智様の接合面と異種金属管機の接合面 上に施こしたニッケル電気メッキ皮膜との間に アルミニウムより簡化し鮮い安定した亜鉛、鰯、 結晶構造の異なるニッケルの単独或はこれらの **台金による金属皮膜が介在し、その結果生成さ** れるアルミニウム、ニッケルの合金属の組織、 組成に間溶範期の広い安定した合金層が得られ て脆弱な金属間化合物の生成が抑制されたもの と考えられる。

### 以驗結果

本発明法の実施例として実施したアルミニ

ム管の嵌合接合面を無処理或は研磨処理して接合しても特開的51-134344号発明のニッケル合金の皮膜層を介在させる接合と同様本結明 法による接合と比較して使用目的に応じた所要 強度を得られない襲れがあるのみならず、接合 条件も不安定である。

尚異種金属管として鰯、黄銅について述べて 水たが鰯管についても強度の緩れた接合が得ら れる。

又智のみならすアルミニウム様と典種金属株との尖き合せ接合でも優れた接合が得られる。 又尖き合せ接合でも良い。

本発明は叙上のようにアルミニウム智祥と嫋、 黄銅等の異複金属管様の各端部を互いに突 き合せ或は雌雄の篏合接合面とし、アルミニウム管様の接合面に亜鉛、ニッケル、鯯と亜鉛の合金により り金属皮膜を形成すると共に、異種金属管様の 総合面にはニッケル響気メッキ皮膜を施し、これら互いの接合面を突き合せ或は嵌合した接合

ウム管と銅管或は黄銅管の接合部の強度試験 は嵌合接合部を平板間にはさみ属平に押しつ ぶした後試料内部に 10kg/cd の空圧を加え水 中に嵌合接合部を挿入して気泡の発生の有無 を調べ扁平気密試験により接合部の強度試験 を行なった。

#### 尚扁平塞るは

(扁平前の外径一扁平後の外径) ナ

(扁平前の外径)×100

で扱わしたものである。

A & 8.0 × 1.0 端部フレア加工

Cu 又は黄銅管 8.0 × 0.5

又試験結果中 1) ~ 10 )までは本発明実施品である。

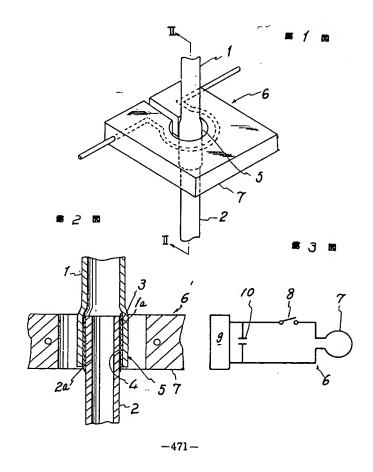
	Aℓ側の表面処理	Cu 側の表面処理	黄銅側の表面処理	扁平気密試験結果	開平気密試験 20 % を合格差準とした 場合の不良率
1)	亜鉛 沈 着	Ni 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
2)	<b>亜鉛化着</b>		Ni 電気メッキ	> 40 %	< 3 %
3)	亜鉛+ Ni 沈碧	Ni 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
4)	Ni 沈潛	NI 電気メッキ		> 40 %	< 3 %
5)	亜鉛+ Ni 沈着		Ni電気メッキ	> 40 %	< 3 %
6)	Ni 沈着		Ni 電気メッキ	> 40 %	< 3 %
7)	Cu 沈着	Ni電気メッキ		> 40 %	< 3 %
8)	Cu 沈潛		Ni電気メッキ	> 40 %	< 3 %
9)	黄銅(Cu+Zn)沈着	Ni電気メッキ		> 40 %	<3 %
10)	黄銅(Cu+Zn) <b>次層</b>	Ni 電気メッキ	Ni 常気メッキ	> 40 %	< 3 %
11)	なし			< 10 %	100 %
12)	α L	無電解Niメッキ		< 10%	100%
13)	なし		r L	< 10 %	100 %

	∧ℓ 側の表面処理	Cu側の表面処理	苗銅伽の表面処理	扁平気密試験結果	扁平気密試験 20% を合格基準とした 場合の不良器
14)	t L		無電解 Niメッキ (Ni沈着)	<10 %	. 100%
15)	₹ L	Ni 電気メッキ		10~ <50%	15 ~ 20 %
16)	te L		Ni 摩気メッキ	1 0 ~ < 50 %	15 ~ 25 %
17)	Zu 沈着	無電解 Ni メッキ		<10 %	100 %
18)	Zu 沈着	и L		<10 ≴	100 %
19)	Ni 沈潜	無電解Niメッキ		<10 %	100 %
20)	Ni沈滑	なし		<10 %	100 %
21)	Zn + Ni 沈沿	無電解 Ni メッキ		<10 <b>%</b>	100 ≴
22)	Zn + Ni 沈滑	なし		<10 %	100 \$
23)	Cu 沈滑	無電解Niメッキ		<10 %	100 ≴
24)	Cu 沈筹	r L		<10 %	100 %
25)	黄銅(Cu+Zn)次管	無容解 Niメッキ		<10 <b>%</b>	100 %
	1	1			

## 4. 図面の開単な説明

第1図は本発明法の実施説明図、第2図は第1図 || 一 || 線断面拡大説明図であり、第3図は本発明法に使用する電磁圧接接置の回路図である。

- 1 はアルミニウム質
- 1 att 液合接合面
- 2 は具褐金属質
- 28 は接合面
- 3 社金屬皮膜
- 4 はニッケル電気メッキ皮膜
- 5 は接合部
- 6 は電磁圧接装置
- 7 は加工コイル



11/13/04, EAST Version: 2.0.1.4